

东芯半导体股份有限公司投资者关系活动记录表

(2025年5月26日)

证券代码：688110

证券简称：东芯股份

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（）
参与单位名称	长盛基金、华福证券、易方达基金、深圳红钧资本、深圳恒泽私募、倍特基金
活动时间	2025年5月20日、5月21日、5月23日
活动地点	公司会议室、电话会议
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书：蒋雨舟 证券事务代表：黄沈幪 投资者关系：王佳颖
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司对存储的几条产品线的定位？</p> <p>答：SLC NAND 方面，公司会保持在大陆市场的领先地位，不断增加产品料号，推进产品制程更迭，不断提升该产品线的市占率。NOR 产品方面公司积极推进 55nm 产线的中高容量产品的推出，努力提升市场份额，开拓新的终端市场。DRAM 一方面会将重心放在 LPDDR 产品系列，推进 LPDDR4x 产品进度和客户导入，另一方面会持续做利基型的标准品 DDR。MCP 产品稳步发展，进行组合的迭代，积极配合下游模块客户的需求，从 4Gb+4Gb 的方案迭代到 8Gb+8Gb、16Gb+16Gb 的方案并努力提高车规 MCP 的营收占比。</p> <p>2、公司对于 Wi-Fi 芯片产品能看到多大的市场空间？</p> <p>答：公司看到 Wi-Fi 芯片市场广阔的空间，特别是 Wi-Fi 6/7 在高带宽、高安全性、低延时以及对多设备同时接入有较高要求的场景具备明显优</p>

	<p>势，未来将成为 Wi-Fi 芯片市场增长的主要驱动力，伴随着智能手机、笔记本电脑、物联网(IoT) 设备、智能家电和其他联网设备的使用不断增加，推动了对 Wi-Fi 芯片组的需求，并增加了对可靠、快速无线通信的需求。物联网(IoT) 的普及导致各种应用对 Wi-Fi 芯片组的需求增加，包括可穿戴技术、智能家电、工业自动化、医疗设备等。随着互联网连接在发展中国家的普及，对低成本 Wi-Fi 设备的需求增加，未来也将推动 Wi-Fi 芯片市场的增长。</p> <p>3、今年的费用方面是什么趋势？</p> <p>答：公司研发投入稳步上升，公司不断提升技术创新能力，深耕关键技术攻关，增强技术领先性，积累核心技术优势。公司将持续保持高水平研发投入。</p> <p>4、车规产品方面公司目前进展如何？</p> <p>答：车规级存储产品上，公司 SLC NAND、NOR 以及 MCP 等产品陆续有更多料号通过 AEC-Q100 的验证，将适用于要求更为严苛的车规级应用环境。公司积极进行车规客户的导入和验证，2024 年新增完成国内多家整车厂的白名单导入，完成多家境内外一级汽车供应商（Tier1）的供应商资质导入，并已向包括境外知名的一级汽车供应商（Tier1）等进行车规产品的销售。</p>
日期	2025 年 5 月 26 日